

2025年7月22日

各 位

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬と晉一化工、COMNEXT 2025に共同出展！
～次世代通信を支える高機能材料をご紹介～

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、グループ会社である晉一化工股份有限公司（本社：台湾・台北市）とともに、7月30日（水）から8月1日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「COMNEXT 第3回〔次世代〕通信技術&ソリューション展」に共同出展します。

COMNEXTは、光通信技術、5G/6G通信技術、ローカル5G、映像伝送、AI・IoTソリューションなど、次世代通信技術に特化した展示会です。当社および晉一化工は、次世代通信を支える革新的な高機能材料を通じて、通信技術のさらなる進化と持続可能なデジタル社会の発展に貢献してまいります。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。



【出展概要】

展示会名：COMNEXT 第3回〔次世代〕通信技術&ソリューション展

5G/6G WORLD 【公式サイト】<https://www.cbw-expo.jp/ja-jp/about/mob.html>

期 間：2025年7月30日（水）～8月1日（金）10：00～17：00

場 所：東京ビッグサイト 南展示棟（東京都江東区有明3-11-1）

当社ブース 南2ホール 小間番号 C11-30

入 場 料：無料 展示会へのご入場には必ず来場登録が必要です。

[こちら](#)からご登録ください。

<https://www.cbw-expo.jp/ja-jp/register.html?code=1394572959867200-IDG>

【展示概要】

1. 第一工業製薬 展示内容

情報通信関連材料のご紹介

～界面制御技術を活かした高性能材料で、次世代の通信インフラを支える～

界面制御技術を生かし、情報通信分野向けに高性能材料を開発しています。実装基板やプリント基板材料、パッケージ材料向け製品と応用例をご紹介します。

次世代高速通信向け低誘電樹脂 「MP-1250」

～低誘電×高 Tg。設計自由度を備えた高機能樹脂で通信性能向上に貢献～

「MP-1250」は、低誘電特性と高 Tg を兼ね備えた炭化水素系熱硬化性樹脂で、次世代高速通信機器の性能向上に貢献します。誘電特性への影響を抑えながら、柔軟なカスタマイズが可能です。

常温硬化型高強度樹脂～エポキシ樹脂代替～

～加熱不要・短時間硬化で、環境に優しく生産性向上に貢献する次世代樹脂～

当社の常温硬化型高強度ウレタン樹脂は、無溶剤で高 Tg・高強度を実現。加熱工程を省くことで生産効率を高め、環境負荷の低減にも貢献します。持続可能な製造現場に最適な新素材をご紹介します。

非水系分散剤

～減粘×分散安定化。機能性フィラーの高充填化に貢献～

非水系で高い効果を発揮する分散剤で、フィラーの高充填化やスラリーの減粘・分散安定化に貢献します。放熱材料、電磁波吸収・シールド材、封止剤など多様な用途に対応可能です。

2. 晋一化工 展示内容

晋一化工は 1975 年の創立以来、繊維助剤、プラスチック添加剤、基板樹脂などの、多様な製品開発に取り組んできました。近年では、地球温暖化や低炭素社会の実現に向けた解決策として、生化学および電気化学の観点から、台湾の農業・エネルギー分野へと視野を広げています。持続可能な環境の実現をめざし、邁進しています。

炭化水素樹脂

熱硬化性ポリスチレン誘導体および熱硬化性環状オレフィン共重合体

5G・6G 通信領域材料

超低誘電反応性リン系難燃剤

6G 通信領域材料

中空シリカ粒子

半導体パッケージング材料

ビスマレイミド樹脂

5G 通信絶縁材料

熱硬化性低誘電ポリイミド樹脂

以上

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報 IR 部

TEL: 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2